

フッ素樹脂の研究開発・テクニカルサービス（26 化学開発 04.）

ダイキン工業株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体）のご経験のある…

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
ダイキン工業株式会社

Job ID
1598471

Industry
Electronics, Semiconductor

Job Type
Permanent Full-time

Location
Osaka Prefecture

Salary
6 million yen ~ 12 million yen

Work Hours
08:30 ~ 17:00

Holidays
【有給休暇】初年度 14日 3か月目から 完全週休2日制、夏季休暇、年末年始、慶弔、育児・介護休暇制度、有給休暇：年次有給22…

Refreshed
November 13th, 2026 18:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2387602】
【担当業務】
■業務内容
半導体関連用途を中心としたフッ素樹脂製品の開発業務およびテクニカルサービスを担当いただきます。具体的には、顧客要求に基づく材料・製品設計、評価試験、性能検証、課題抽出と改善提案を行い、営業や生産部門とも連携しながら案件を推進します。また、顧客現場での技術的な対応やトラブルシュート、製品適用に向けた技術サポートも重要な役割です。顧客との接点を通じて新たな開発のアイデアを獲得するのも重要なミッションです。前職で培った知見を活かし、リーダーとしてチームを牽引していただくことを期待しています。

■具体的な担当業務
・半導体配管部材用の新製品開発のリーダー業務
・フッ素樹脂技術者とともに、新製品開発の方針立案とラボでの検証。
・知財部門と相談しながら特許出願
・製造部門と連携しながら量産検討
・他部署と相談しながら商品化の推進（法規、採算性、品質管理）
・開発した製品の顧客（配管部材メーカー、半導体製造装置メーカー、エンジ会社、デバイスメーカー）への営業PR活動

【使用ツール】
一般分析機器、物性測定装置（IR、引張試験機など）。
事務的にはエクセル、ワード、パワーポイント。

【ポジション・立場】
新製品開発、テクニカルサービスを行うチームのなかで、半導体配管部材用の新製品開発の中核メンバーとして自律的な活躍を期待しています。

Required Skills

※以下、スタッフクラス～管理職共通です。

■経験分野・年数
【必須】以下のいずれか、または合計の経験年数5年以上に該当される方
・半導体配管部材用（チューブ、接手、バルブ）の樹脂（フッ素樹脂、PEEKなど）開発経験
・半導体配管部材（チューブ、接手、バルブ）の開発、設計経験
・半導体製造工場の配管部材に関わる分野の設計経験
・半導体製造装置（洗浄乾燥装置、フォトリソ工程装置、CMP装置）内の配管部材に関わる研究・開発・設計経験
・半導体デバイスメーカーで薬液の配管部材や半導体製造装置の選定や仕様改造に関わる業務

【尚可】
・テクニカルサービスや技術営業の経験
・特許出願実績
・樹脂の押出、成形経験
・樹脂のレオロジーに関する知識
・結晶構造に関する知識、X線結晶解説を用いての測定経験

■専攻学科
【尚可】
化学系出身または、機械系に精通し、化学の（専門）知識がある方が好ましい

■資格：不問

Company Description

空調・冷凍機、化学、その他製品の開発、製造、販売、サービス